ESPEC

第5G通信技術展 に出展いたします!

5G機器・デバイスの開発において、デバイスの発熱量増加を踏まえた 信頼性試験や幅広い温度環境下での動作試験の実施が求められます。 エスペックでは、5G機器・デバイスの開発や設計、製造に役立つ 多種多様な試験装置をご紹介いたします。

出展予定製品



2022年6月29日(水)~7月1日(金) 10:00~18:00 (最終日は17:00終了)

会場

東京ビッグサイト 西1ホール

ブースNo.: 1-25

基地局/通信機器の評価



小型環境試験器シールド仕様

温度範囲: -40℃~+100℃の卓上タイプでシールド機能を有した恒温器。省スペースで端末、エッジデバイスの高/低温動作試験や温度特性試験時のEMC対策に最適です。



電波暗箱型低温恒温器/恒温室

電波暗箱/室の機能と恒温槽/室の機能を 兼ね備えた、電波無響環境下での温度環境 試験が可能な複合環境試験器です。

プリント実装基板/配線の評価



NEW 卓上型無風恒温槽

半導体デバイスやプリント実装基板の温度特性 評価・熱解析の検証に最適な温度範囲:-30℃~ +130℃の卓上型無風恒温槽です。



スポット冷却加熱装置

温度範囲: -40℃~+180℃に温度調節した空気を噴射、試料を直接冷却・加熱し、試験を効率化するチャンバーレスシステムです。





スライド扉式小型環境試験器

インターフェイス付き扉、扉スライド機構、扉一体型スライドトレイにより配線作業が容易で、さらに配線距離の短縮が図れることで測定精度を向上した恒温(恒湿) 器です。

高周波/高耐熱のインダクタ・コンデンサ評価、実装評価



積層パワーインダクタ 信頼性評価試験装置

最大250℃の高温下でパワーインダクタへ大電流を流すことでデバイスの加速寿命試験が可能。 また、寿命評価に欠かせないワイブルプロットを標準機能としてご提供いたします。



高周波インダクタ/コンデンサ 温度特性評価試験装置

恒温槽内で広範囲の温度下において最大100MHz の周波数でインダクンスや容量(C)測定をご提供。また、プローブシステムでの提案では、最大3GHzまでの特性取得が可能です。





エレクトロケミカルマイグレーション評価システム/ **導体抵抗評価システム**

低温・高温の温度サイクル環境下において、はんだ接合部やコネクタ接続部の導体部分の微小抵抗値を連続測定。パソコンによる自動計測、データ収録およびデータ処理のシステム化により、より正確な接続信頼性評価が可能です。

5G/IoTウェビナー ── 公開中! ──



視聴はこちらをクリック

5G • IoT Solution Expo

●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク 0120-701-678

おかげさまでエスペック株式会社は75周年を迎えます エスペック株式会社 https://www.espec.co.jp/

